



半導体デバイス製造技術基礎セミナー2021

(公社)精密工学会 プラナリゼーションCMP 委員会

日時

2021年12月16日(木)8:30-17:30

方式

Zoom を使った LIVE 配信セミナー

対象者・募集人数

対象者: 半導体デバイス製造技術の基礎を理解されたい方

CMP に携わる研究者、技術者からマーケティング、営業にいたるビジネスパーソン

募集人数: 80 名

募集期間: 2021年10月8日~11月30日

概要

本セミナーは、半導体デバイス製造技術の基礎として、CMOS プロセス、メモリデバイス、ロジックデバイスを概説し、さらに後工程技術に関しても幅広く説明します。専門技術である CMP に留まらず、半導体デバイス製造技術を理解する入門講座としておすすめのセミナーです。

講師

ウエスタンデジタル合同会社 シニアコーポレートアドバイザー 久保田 勝彦

ワイドヴィル (元東京エレクトロン株式会社) 廣田 良浩

株式会社 ISTL 磯部 晶

グローバルネット株式会社 武野 泰彦

効果・到達目標

座学のみならず、ブレイクアウトセッションによるグループ討議を通じて講師・受講者間の双方向の能動的な学習を行うことにより、半導体デバイスと CMP 技術を含めた半導体製造技術の理解を深める。

スケジュール

12月16日(木)

8:30-8:45 オープニング

8:45-11:45 CMOS プロセス技術の基礎概論 (180 分)

12:00-12:45 休憩

12:45-13:30 Breakout Session (45 分)

13:30-14:30 メモリ技術全般 (60 分)

14:45-15:45 先端ロジックデバイスと CMP 技術 (60 分)

16:00-16:45 後工程プロセス (45 分)

17:00-17:20 Breakout Session Feedback (20 分)

17:20-17:30 クロージング

受講料

10,000 円 (一般参加)

5,000 円(2021.8.27-28 開催した CMP Webinar 参加者及び学生)

- a. やむを得ずキャンセルの場合は、原則開催日の前営業日の午後 3 時までにご連絡をください。
- b. 開催日当日のキャンセルの場合は、受講料を全額ご請求いたします。
- c. 代理参加は受付いたします。

受講について

・配布資料

開催前日までに PDF にてお送りいたします。

無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。

・Zoom を使った WEB 配信セミナー受講の手順

Zoom を使用されたことがない方は、[こちら](#)からミーティング用 Zoom クライアントをダウンロードしてください。ダウンロードできない方はブラウザ版でも受講可能です。セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。

開催日直前に WEB セミナーへの招待メールをお送りいたします。当日のセミナー開始 10 分前までに招待メールに記載されている視聴用 URL より WEB 配信セミナーにご参加ください。

お申込み

ホームページからのオンライン参加登録をご利用ください。

連絡先

「プラナリゼーション CMP 委員会」事務局(三上)

TEL; 03-5117-2225/FAX; 03-5117-2223

Email:mikami@global-net.co.jp